

无锡泰连芯科技有限公司

TLX4G86 型
四路 2 输入异或门

2024 年 06 月

TLX4G86 四路 2 输入异或门

1 特点

- 工作电压范围：1.65V 至 5.5V
- 低功耗：1μA（最大值）
- 工作温度范围：
-55℃ 至 +125℃
- 输入接受电压高达 5.5V
- 高输出驱动：±24mA（V_{CC}=3.0V）
- 封装：SOP14 和 TSSOP14

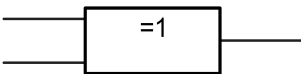
2 应用

- AV 接收器
- 蓝光播放器和家庭影院
- 数码相框（DPF）
- 高速数据采集和生成
- 个人导航设备（GPS）
- 便携式媒体播放器

逻辑符号



IEE/IEC 逻辑符号



3 描述

TLX4G86 四路 2 输入异或门设计用于 1.65V 至 5.5V_{V_{CC}}操作。

TLX4G86设备执行布尔函数 $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ 正逻辑。该器件完全适用于使用 I_{off} 的部分断电应用。 I_{off} 电路禁用输出，防止断电时电流回流到设备造成损坏。

TLX4G86 提供绿色 SOP14和TSSOP14两种版本 封装。其工作环境温度范围为-55℃至+125℃。

质量等级：军温级&N1级

设备信息⁽¹⁾

产品编号	封装	主体尺寸（标称）
TLX4G86	SOP14	8.65mm×3.90mm
	TSSOP14	5.00mm×4.40mm

(1) 对于所有可用的封装，请参阅数据表末尾的可订购附录。

4 功能表

输入		输出
A	B	Y
H	H	L
L	H	H
H	L	H
L	L	L

H=高电压电平
L=低电压等级

目录

1 特点	2
2 应用	2
3 描述	2
4 功能表	2
5 修订历史	4
6 封装/订购信息 ⁽¹⁾	5
7 引脚配置	6
8 规格	7
8.1 绝对最大额定值 ⁽¹⁾	7
8.2 ESD 额定值	7
9 电气特性	8
9.1 建议工作条件	8
9.2 直流特性	9
9.3 交流特性	9
10 参数测量信息	10
11 封装外形尺寸	11
12 卷带信息	13

5 修订历史

注意：以前修订的页码可能与当前版本的页码不同。

版本	变更日期	更改项目
A.1	2021/01/21	初始版本完成
A.2	2021/12/22	添加了磁带和卷轴信息
A.3	2023/09/20	1. 更新 V_{IH} , V_{IL} 参数 2. 更新 ESD 额定值 3. 在第5页@RevA.2添加MSL
A.3.1	2024/02/29	修改包装命名

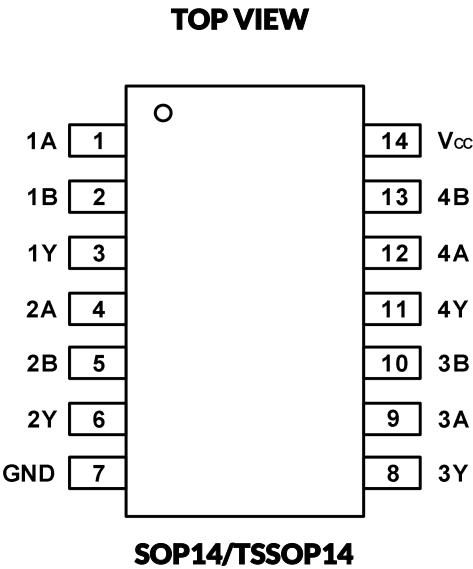
6 封装/订购信息⁽¹⁾

订购型号	温度等级	封装类型	丝印标记 ⁽²⁾	MSL	质量等级
JTLX4G86XP	-55 °C ~+125 °C	SOP14	TLX4G86	MSL1/3	N1/军温级
JTLX4G86XQ	-55 °C ~+125 °C	TSSOP14	TLX4G86	MSL1/3	N1/军温级
TLX4G86XP	-40 °C ~+125 °C	SOP14	TLX4G86	MSL1/3	工业级
TLX4G86XQ	-40 °C ~+125 °C	TSSOP14	TLX4G86	MSL1/3	工业级

笔记:

- (1) 此信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，亦不会修订本文档。如需此数据表的浏览器版本，请参阅右侧导航栏。
- (2) 可能有额外的标记，涉及批次跟踪代码信息（数据代码和供应商代码）、设备上的徽标或环境类别。
- (3) MSL，根据 JEDEC 行业标准分类的湿度敏感度等级评定。

7 引脚配置



引脚说明

引脚	代码	I/O ⁽¹⁾	功能
SOP14 / TSSOP14			
1	1A	I	通道1逻辑输入
2	1B	I	通道1逻辑输入
3	1Y	O	逻辑电平输出1
4	2A	I	通道2逻辑输入
5	2B	I	通道2逻辑输入
6	2Y	O	逻辑电平输出2
7	GND	-	接地
8	3Y	O	逻辑电平输出3
9	3A	I	通道3逻辑输入
10	3B	I	通道3逻辑输入
11	4Y	O	逻辑电平输出4
12	4A	I	通道4逻辑输入
13	4B	I	通道4逻辑输入
14	Vcc	-	电源

(1) I=输入 , O=输出 , P=电源 , G=地。

8 规格

8.1 绝对最大额定值⁽¹⁾

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）⁽¹⁾⁽²⁾

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围		-0.5	6.5	V
V_I	输入电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_O	施加于高阻抗或断电状态下任何输出的电压范围 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V_O	施加于高状态或低状态任何输出的电压范围 ⁽²⁾⁽³⁾		-0.5	V _{CC} +0.5	V
I_{IK}	输入钳位电流	V _I <0		-50	mA
I_{OK}	输出钳位电流	V _O <0		-50	mA
I_O	连续输出电流			±50	mA
	持续电流通过 V _{CC} 或 GND			±100	mA
θ_{JA}	封装热阻 ⁽⁴⁾	SOP14		105	°C/W
		TSSOP14		90	
T_J	结温 ⁽⁴⁾		-55	150	°C
T_{stg}	储存温度		-65	150	°C

(1) 超出“绝对最大额定值”所列的应力可能会对器件造成永久性损坏。这些应力仅为额定值，并不保证器件在这些条件下或任何其他超出“建议工作条件”所列的条件下能够正常工作。长时间暴露于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则可能会超过输入和输出负电压额定值。

(3) 建议工作条件表中提供了 V_{CC} 的值。

(4) 封装热阻按照 JESD-51 计算。

(5) 最大功耗是 T_{J(MAX)}、R_{θJA} 和 T_A 的函数。任何环境温度下允许的最大功耗为 P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{θJA}。所有数值均适用于直接焊接在 PCB 上的封装。

8.2 ESD 额定值

以下 ESD 信息仅适用于在 ESD 保护区内处理 ESD 敏感设备。

			数值	单位
V_(ESD)	静电放电	人体模型 (HBM), MIL-STD-883K 方法 3015.9	±2000	V
		充电器件模型 (CDM), ANSI/ESDA/JEDEC JS-002-2018	±1000	V
		机械模型 (MM), JESD22-A115C (2010)	±200	V



ESD 敏感度警告

ESD 损害的范围很广，从轻微的性能下降到器件的彻底失效。精密集成电路更容易受到损坏，因为即使很小的参数变化也可能导致器件不符合其公开的规格。

9 电气特性

在建议的工作自然通风温度范围内（除非另有说明，典型值是在 $T_A = +25^{\circ}\text{C}$ 、满载值 = -55°C 至 125°C 下测得的。）⁽¹⁾

9.1 建议工作条件

范围	代码	测试条件	最小值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	操作	1.65	5.5	V
		仅保留数据	1.5		
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=1.65\text{V to }1.95\text{V}$	$0.65 \times V_{CC}$		V
		$V_{CC}=2.3\text{V to }2.7\text{V}$	1.7		
		$V_{CC}=3\text{V to }3.6\text{V}$	2		
		$V_{CC}=4.5\text{V to }5.5\text{V}$	$0.7 \times V_{CC}$		
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=1.65\text{V to }1.95\text{V}$		$0.35 \times V_{CC}$	V
		$V_{CC}=2.3\text{V to }2.7\text{V}$		0.6	
		$V_{CC}=3\text{V to }3.6\text{V}$		0.8	
		$V_{CC}=4.5\text{V to }5.5\text{V}$		$0.3 \times V_{CC}$	
输入电压	V_I		0	5.5	V
输出电压	V_O		0	V_{CC}	V
输入跃变上升或下降	t_r, t_f	$V_{CC}=1.8\text{V} \pm 0.15\text{V}, 2.5\text{V} \pm 0.2\text{V}$		20	ns/V
		$V_{CC}=3.3\text{V} \pm 0.3\text{V}$		10	
		$V_{CC}=5\text{V} \pm 0.5\text{V}$		5	
工作温度	T_A		-55	+125	$^{\circ}\text{C}$

(1) 器件的所有未使用的输入必须保持在 V_{CC} 或 GND 以确保器件正常工作。

9.2 直流特性

范围		测试条件	电压 _■	温度	最小 ⁽²⁾	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
V _{OH}		I _{OH} = -100 μ A	1.65V to 5.5V	Full	V _{CC} -0.1			V
		I _{OH} = -4mA	1.65V		1.2			
		I _{OH} = -8mA	2.3V		1.9			
		I _{OH} = -16mA	3V		2.4			
		I _{OH} = -24mA			2.3			
		I _{OH} = -32mA	4.5V		3.8			
V _{OL}		I _{OL} = 100 μ A	1.65V to 5.5V	Full			0.1	V
		I _{OL} = 4mA	1.65V				0.45	
		I _{OL} = 8mA	2.3V				0.3	
		I _{OL} = 16mA	3V				0.4	
		I _{OL} = 24mA					0.55	
		I _{OL} = 32mA	4.5V				0.55	
I _i	A or B inputs	V _i =5.5V or GND	0V to 5.5V	+25°C		±0.1	±1	μA
				Full			±5	
I _{off}		V _i or V _O =5.5V	0V	+25°C		±0.1	±1	μA
				Full			±10	
I _{CC}		V _i =5.5V or GND, I _o =0	1.65V to 5.5V	+25°C		0.1	1	μA
				Full			10	
Δ I _{CC}		One input at V _{CC} -0.6V, Other inputs at V _{CC} or GND	3V to 5.5V	Full			500	μA

(1) 器件的所有未使用的输入必须保持在 V_{CC} 或 GND 以确保器件正常工作。

(2) 限值是在 25°C 下进行 100% 生产测试得出的。工作温度范围内的限值通过统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保。

(3) 典型值代表特性测定时确定的最可能的参数标准。实际典型值可能随时间变化，并取决于应用和配置。

9.3 交流特性

(除非另有说明, $T_A = -55^\circ C$ 至 $+125^\circ C$, 典型值为 $T_A = +25^\circ C$ 。)(1)

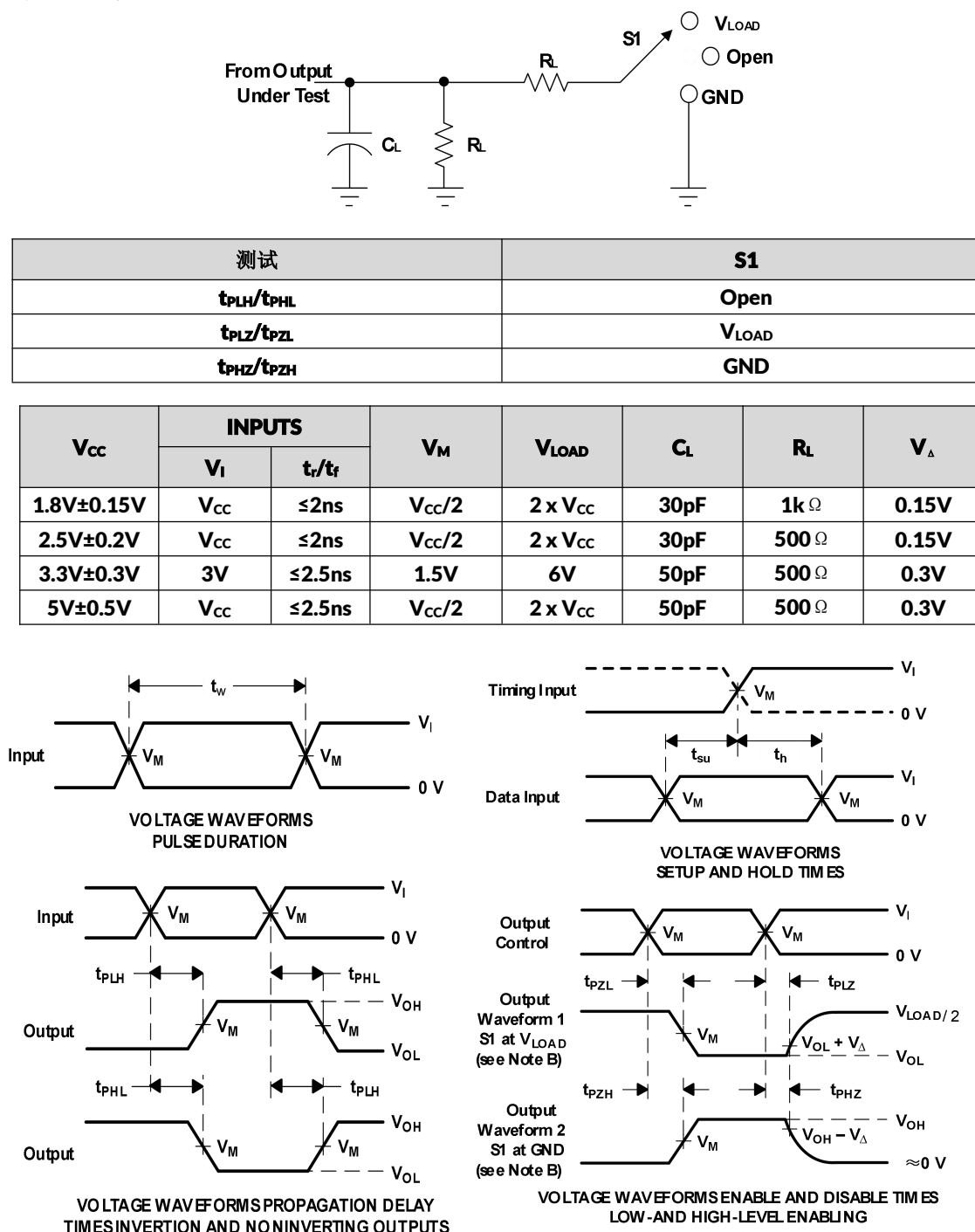
范围	象征	测试条件		最小 ⁽²⁾	典型 ⁽³⁾	最大 ⁽²⁾	单位
传播延迟	t_{pd}	$V_{CC}=1.8V \pm 0.15V$	$C_L=30pF, R_L=1k \Omega$		14.2		ns
		$V_{CC}=2.5V \pm 0.2V$	$C_L=30pF, R_L=500 \Omega$		11.1		
		$V_{CC}=3.3V \pm 0.3V$	$C_L=50pF, R_L=500 \Omega$		6.7		
		$V_{CC}=5V \pm 0.5 V$	$C_L=50pF, R_L=500 \Omega$		5.3		
输入电容	C_i	$V_{CC}=3.3V$	$V_i=V_{CC}$ or GND		4		pF
功率耗散电容	C_{pd}	$V_{CC}=1.8V$	$f=10MHz$		20		pF
		$V_{CC}=2.5V$			21		
		$V_{CC}=3.3V$			22		
		$V_{CC}=5V$			25		

(1) 器件的所有未使用的输入必须保持在 V_{CC} 或 GND 以确保器件正常工作。

(2) 此参数由设计和/或特性确保，并未在生产中测试。

(3) 典型值代表特性测定时确定的最可能参数标准。实际典型值可能随时间变化，并取决于应用和配置。

10 参数测量信息



注：

A. C_L 包括探头和夹具电容。

B. 波形 1 用于具有内部条件的输出，即输出为低，除非被输出控制禁用。

波形 2 表示具有内部条件的输出，即输出为高，除非被输出控制禁用。

C. 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 10 \text{ MHz}$ ， $Z_o = 50 \Omega$ 。

D. 每次测量一个输出，每次测量一个转换。

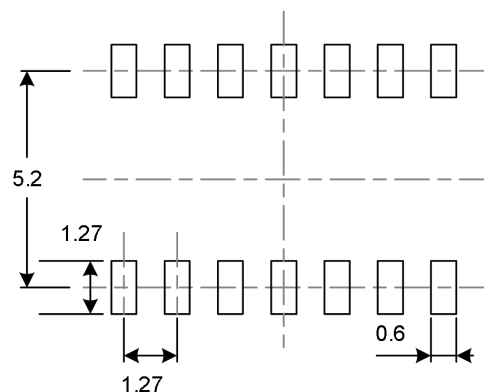
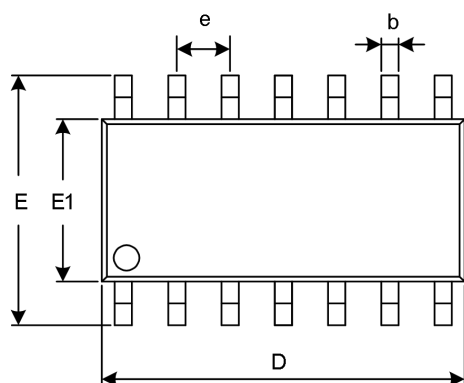
E. t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 与 t_{dis} 相同。F. t_{PZL} 和 t_{PZH} 与 t_{en} 相同。G. t_{PLH} 和 t_{PHL} 与 t_{pd} 相同。

H. 所有的参数和波形并不适用于所有的设备。

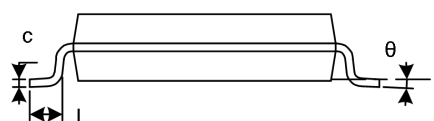
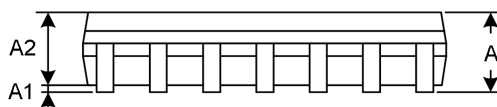
图 1. 负载电路和电压波形

11 封装外形尺寸

SOP14⁽³⁾



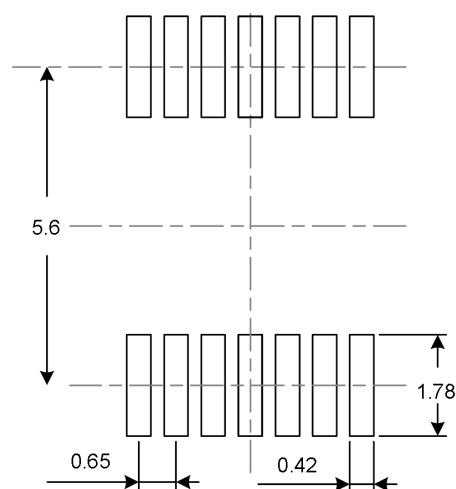
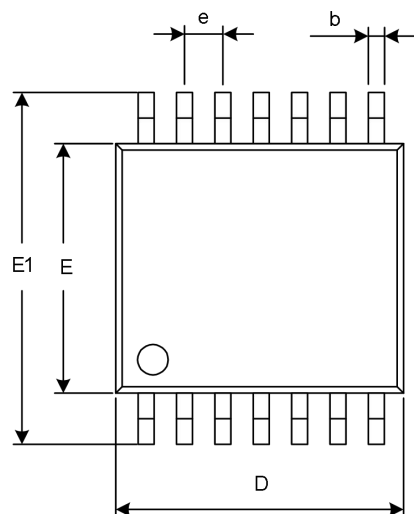
RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



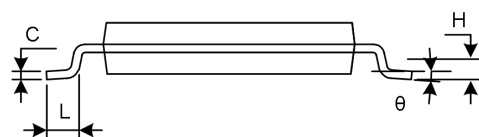
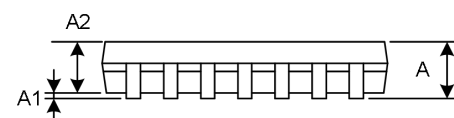
代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A⁽¹⁾		1.750		0.069
A1	0.100	0.250	0.004	0.010
A2	1.300	1.500	0.051	0.059
b	0.390	0.470	0.015	0.019
c	0.200	0.240	0.008	0.009
D⁽¹⁾	8.550	8.750	0.336	0.344
e	1.270(BSC)⁽²⁾		0.050(BSC)⁽²⁾	
E	5.800	6.200	0.228	0.244
E1⁽¹⁾	3.800	4.000	0.150	0.157
L	0.500	0.800	0.020	0.031
θ	0°	8°	0°	8°

笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有更改, 恕不另行通知。

TSSOP 14⁽³⁾

RECOMMENDED LAND PATTERN (Unit: mm)



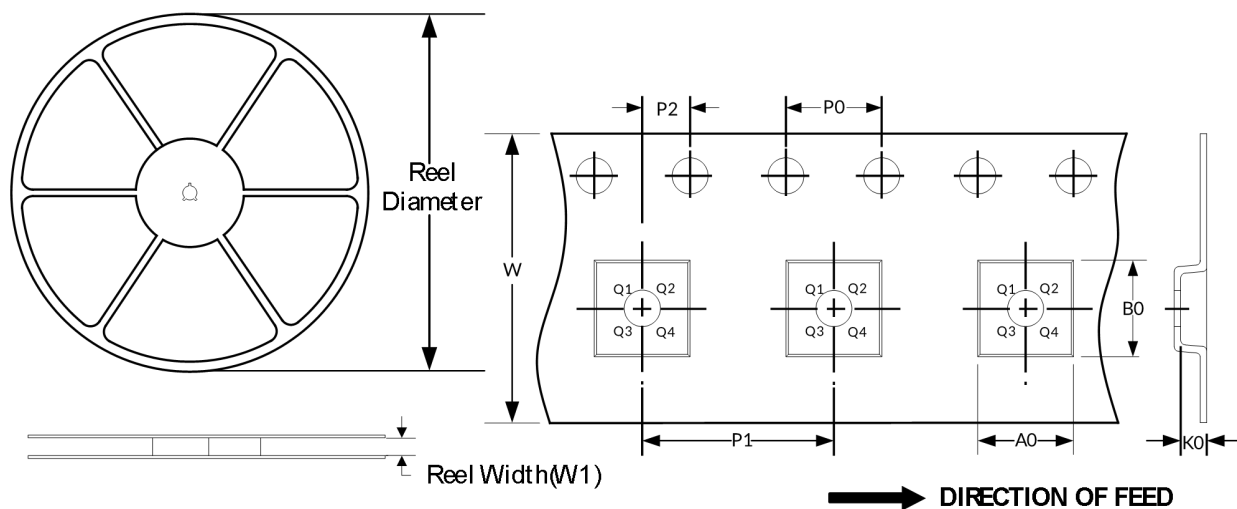
代码	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.200	0.300	0.008	0.012
c	0.130	0.170	0.005	0.007
D ⁽¹⁾	4.860	5.100	0.191	0.201
E ⁽¹⁾	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.200	6.600	0.244	0.260
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
L	0.450	0.750	0.018	0.030
H	0.250(TYP)		0.010(TYP)	
θ	0°	8°	0°	8°

笔记:

1. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。
2. BSC (中心间基本间距), “基本”间距是名义上的。
3. 本图纸如有更改, 恕不另行通知。

12 卷带信息

卷轴尺寸 磁带尺寸



注：图片仅供参考，请以实物为准。

卷带封装关键参数表

封装类型	卷轴直径	卷轴宽度 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOP14	13"	16.4	6.60	9.30	2.10	4.0	8.0	2.0	16.0	Q1
TSSOP14	13"	12.4	6.95	5.60	1.20	4.0	8.0	2.0	12.0	Q1

笔记：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每侧最大 0.15 毫米的塑料或金属突出物。